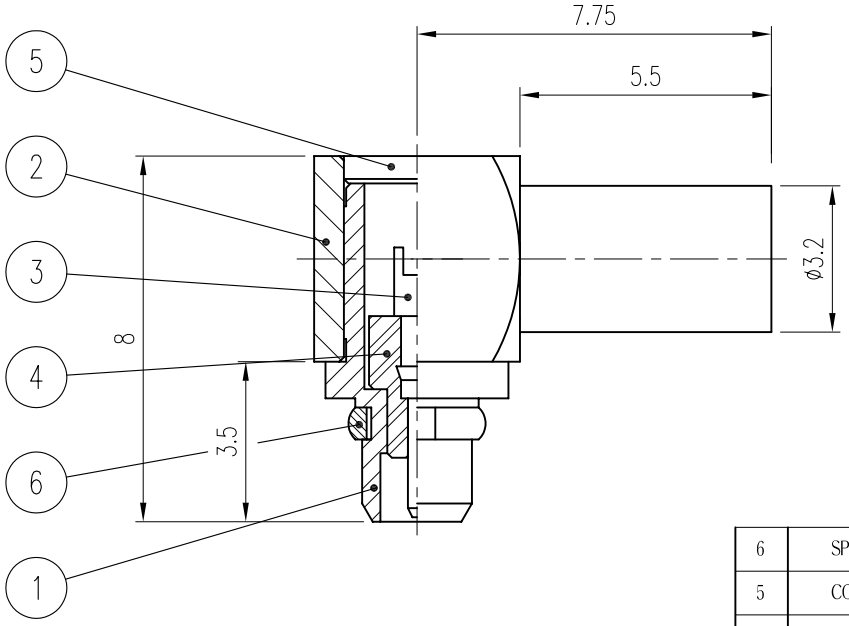
ST \ 가공										
ST(기존)										
ST(개선)										

수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일



품번	품 명	수량	재 질	표면처리	비 고
6	SPRING RING	1	BeCu	Gold Plate	DSR00001-5/1 (R1501)
5	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00007-5/1 (L1501)
4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00014-N/1 (H1501)
3	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00014-5/1 (E1501)
2	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00010-5/1 (D1502)
1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00008-5/1 (D1501)

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질 _____

열처리 _____

보호피막처리 _____

년월일 2003. 5. 23.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량 ___

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 MMCX-LPC-085 VER.0

A4

도번 CN00008-7/1

K311-132-000